

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司**投资者关系活动记录表**

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	摩根基金、华安基金、景顺长城、财通基金、浦银安盛、工银瑞信、南方基金、招商基金、鹏华基金、信达澳亚、安信基金、博时基金、金鹰基金、广发自营、易方达、大成基金、中科沃土、百嘉基金、诺安基金、平安基金、华西自营、昭图投资、旦恩资本、香元基金、长盛基金、华夏基金、汇添富基金、银华基金、新华基金、海富通基金、Optimas Capital、嘉实基金、天弘基金、Blackrock、华泰证券、山西证券、国泰海通资管、咏明资产、磐泽资产、华泰柏瑞、国海证券、华西证券、天风证券、广发证券、国金证券、兴业证券、平安证券、国盛证券、西部证券、中金证券、中泰证券（以上排名不分先后）。	
时间	2026年1月15日至2026年1月30日	
地点	公司会议室、腾讯会议、策略会现场、路演现场等。	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、</p>	

欧美等全球市场。

公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2025 年业绩预增情况介绍

2025 年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长，同时公司持续进行技术研发和产品迭代，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）等需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升，公司 2025 年年度业绩实现较好的增长。

经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元到 21,000 万元，与上年同期相比，将增加 8,151.85 万元到 13,151.85 万元，同比增加 103.87% 到 167.58%。预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,500 万元到 20,500 万元，与上年同期相比，将增加 8,726.35 万元到 13,726.35 万元，同比增加 128.83% 到 202.64%。

以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。

三、调研问答

1、问：2025 年度，业绩预增的主要原因？

答：公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）等需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大

提升，经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元到 21,000 万元，与上年同期相比，将增加 8,151.85 万元到 13,151.85 万元，同比增加 103.87% 到 167.58%。

2、问：公司产品未来升级迭代的方向？

答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。

3、问：客户一般会提前多久下订单？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。

4、问：决定购买测试分选设备的是芯片设计公司还是测试代工厂？

答：两种情况都有，具体要看产品和项目情况。对于量产机型，测试代工厂的话语权会相对多一些；但是对于芯片设计公司有特别测试需求的产品如算力芯片等，芯片设计公司主导测试分选设备的评估，在这种情况下，芯片设计公司通常会直接或者通过测试代工厂与公司沟通设备技术指标等需求。

5、问：能给大家介绍一下先进封装芯片适用于重力式、转塔式、平移式三种测试分选机的适用情况吗？

答：重力式测试分选机是芯片靠自身重力和外部压缩空气在导轨中传送来实现分选过程中的位移，适用于有引脚、有一定重量的封装芯片（如 DIP、SOIC 等）。

转塔式测试分选机是由主转盘内的直驱电机作为动力来源将芯片转动到测试工位上从而实现分选过程中的位移，适用于体积小、重量小的芯片或分立器件。

	<p>平移式测试分选机采用机械臂真空吸取芯片、运输芯片，同测数量多，适用于多种封装类型的芯片。</p> <p>公司的平移式测试分选机主要适用于 QFN（四边扁平无引脚封装），QFP（方型扁平式封装），BGA（球栅阵列封装），LGA（栅格阵列封装），PLCC（塑料有引线片式载体封装），PGA（插针网格阵列封装），CSP（芯片级尺寸封装），TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片。</p> <p>6、问：使用先进封装技术的芯片可以用公司产品进行测试分选吗？</p> <p>答：先进封装是指半导体芯片封装过程中使用的一种先进封装工艺技术，在多种半导体产品的封装过程中都可应用。公司产品测试分选机，是在半导体产品设计验证环节和成品测试环节，配合测试机对芯片封装后的成品进行测试分选。据公司了解，使用 2.5D、3D 等先进封装技术的芯片，其成品多表现为 BGA、LGA、PGA 等封装形式，可以使用公司的设备进行成品测试分选。</p> <p>公司产品集成电路测试分选机在客户公司（半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业、芯片设计公司等）所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G、人工智能等领域中应用的芯片。公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 2 月 3 日